## Al - Cu合金の結晶成長過程のフェーズフィールドシミュレーション

#### 島岡 三義 岩川 光善\*

#### Phase-Field Simulation of Crystal Growth of Al – Cu Alloy

#### Mitsuyoshi SHIMAOKA and Mitsuyoshi IWAKAWA\*

Phase-filed method is useful to predict the dendritic solidification process of alloys. Fundamental theory of phase-filed method for a crystal growth of metal alloy has been explained. Al - 4.5mass% Cu alloy is used as a sample alloy. The computer simulation has been performed and the effects of the undercooling of the melt, the partition coefficient and the liquidus slope in the concentration region of 85 - 100at% Al on the equilibrium phase diagram of Al - Cu alloy on the crystal growth have been examined. The results are summarized as follows : (1) Secondary dendrite arm grew fat with increasing undercooling of the melt, and also these arms grew in the 45° direction of growth of the primary dendrite arms. (2) Tertiary dendrite arms grew with increasing the partition coefficient. (3) The secondary dendrite arms did not occur at the low liquidus slope.

#### 1 はじめに

人類の歴史において青銅器、鉄器などの金属材料の使 用開始は古く、「たたら製鉄」、「東大寺大仏」など、我が 国における製鉄技術や鋳造技術も古い歴史を持ってい る。産業革命以来、金属材料の使用量は飛躍的に増大 し、使用目的に適した膨大な種類の合金が開発されてき ている。しかし、近年は地球環境の保護の観点から、た とえば鉛などの有害な金属を使用しない材料の開発が 進められており、資源の有効利用のためのリサイクル技 術の開発も重要な課題として推進されている。それとと もに凝固組織を制御して必要な機能を得ようとする研 究も進められている。

「鋳造」は大変歴史の古い製造法でありながら、鋳造プロセスにおける鋳型内の湯流れ解析、引け巣や偏析などの鋳造欠陥の予測などが科学的に解明できるようになったのはつい最近のことである<sup>(1),(2)</sup>。また、パーソナルコンピュータの性能向上と金属材料の熱力学データベースの整備により、合金設計において欠くことのできない平衡状態図の設計も可能になってきている。

一方、合金の結晶成長過程そのものをシミュレートし ようという研究も盛んであり、フェーズフィールド法に よる、純金属の他、2元あるいは3元合金、共晶・包 晶・偏晶反応型合金などの結晶成長過程の計算機シミュ レーションが1990年代以降急速に増えてきており<sup>(3)-(7)</sup>、 フェーズフィールド法の有用性が明らかになるにつれ てその解説も増えている<sup>(8)-(11)</sup>。

本報告では、フェーズフィールド法を概説するととも に、本法を用いてAl-4.5mass% Cu合金の2次元的な 結晶成長過程を計算した結果について、特に融液の過冷 度の影響を中心に報告する。

#### 2 フェーズフィールド法の支配方程式<sup>(10)</sup>

既報<sup>(12)</sup>では直交1次元の純物質の、かつ平滑凝固を仮 定しての固相成長の解析手法を解説した。しかし、その ような凝固解析法では図1に示すようなデンドライトの 形状予測は不可能である。2次元凝固、合金の結晶成長 過程のシミュレーションの場合は、凝固(固液)界面に おける境界条件(温度勾配や濃度勾配など)の設定は容 易ではなく、液相と固相の違いを計算機にどう認識させ るかも難しい問題になってくる。フェーズフィールド法 は図2に示すように、固相と液相の間に仮想的に界面領 域2 $\lambda$ を設定し、その領域に0から1の間で変化するス カラー関数 $\phi$  (=  $\phi$ (*x*, *y*, *z*))を適用している。既報<sup>(12)</sup>で 示したマッシー領域は固相(デンドライト)と液相が混 合した領域であり、固相と液相は明確に区分される(図



Fig. 1 Dendrite of Ni-Al-Be alloy.

2の境界領域幅が0と厳密には言えないまでも)。しか し、フェーズフィールド法では固相と液相の境界がほや けたものと考える。この ¢ を「フェーズフィールド」と称 するが、0と1の間のある任意の値の等高線を描くと、 あるいは、0と1の間でグラデーション処理を施すと固 液界面形状が浮かび上がってくるというものである。

フェーズフィールド法では、式(1)のフェーズフィー ルド方程式と式(2-a)の拡散方程式もしくは式(2-b)の熱 伝導方程式を連立させて¢を求める。

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = M \left[ \varepsilon^2 \cdot \nabla^2 \phi - \frac{\partial f}{\partial \phi} \right] \qquad \cdots (1)$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \left\{ \frac{D(\phi)}{\partial^2 f/\partial c^2} \nabla \frac{\partial f}{\partial c} \right\} \qquad \cdots (2-a)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a(\phi) \cdot \nabla^2 T + h(\phi) \cdot \frac{L}{Cp} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial t} \qquad \cdots (2-b)$$

式(1)における  $\partial f/\partial \phi$  の項は  $\phi$  をステップ状に近づける が、 $\nabla^2 \phi$  とのバランスによりフェーズフィールド  $\phi$  の形 状が図2のように決まる。ここで、M、  $\epsilon$  は後述するフェ ーズフィールドパラメータである。 $f(f=(\phi, c, T))$ 、 純金属の場合は $f=(\phi, T)$ )は自由エネルギー密度で、

$$f(\phi, c, T) = h(\phi) \cdot f^{S}(c_{S}(x, y), T) + \{1 - h(\phi)\}$$

・ $f^{\ell}(c_{L}(x, y), T) + W \cdot g(\phi)$  ····(3) であり、 $f^{s}(c_{s}(x, y), T)$ 、 $f^{\ell}(c_{L}(x, y), T)$ は固相、液相の自 由エネルギー密度、 $h(\phi)$ は固相率で、h(0) = 0および h(1) = 1を満たす単調増加関数であればよい。 $W \cdot g(\phi)$ は 固液界面領域のエネルギー障壁に対応した過剰自由エ ネルギーであり、 $g(\phi)$ は2重井戸型関数であればよい。 本研究では $h(\phi)$ 、 $g(\phi)$ はそれぞれ以下の関数形を用いる こととした。

$$h(\phi) = \phi^3 \cdot (6\phi^2 - 15\phi + 10) \cdots (4)$$

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\phi}) = \boldsymbol{\phi}^2 \cdot (1 - \boldsymbol{\phi})^2 \qquad \qquad \cdots (5)$$



Fig. 2 Distribution of phase field,  $\phi$ , near the solid-liquid interface.

なお、固液界面領域においては固相・液相の区別はつけ られないので、式(3)中の固相濃度 $c_s$ と液相濃度 $c_L$ を仮 定しなければならないが、それには固液各相の濃度を平 均化処理する式(6)と、固相、液相の等化学ポテンシャル 条件式(7)を連立させて解く。

 $c(x, y) = h(\phi) \cdot c_{S}(x, y) + \{1 - h(\phi)\} \cdot c_{L}(x, y) \cdots (6)$ 

$$\frac{C_L^{e}}{C_S^{e}} \cdot \frac{1 - C_S^{e}}{1 - C_L^{e}} = \frac{C_L(x, y)}{C_S(x, y)} \cdot \frac{1 - C_S(x, y)}{1 - C_L(x, y)} \quad \dots (7)$$

式(2)でc(c = (x, y, t))は溶質濃度、 $D(\phi)$ は拡散係数 数 ( $\phi \ge 0.9$ で固相の拡散係数、 $\phi < 0.9$ ならば液相の拡 散係数をとる)、T (=T(x, y, t))は温度、 $a(\phi)$ は熱拡 散率 ( $\phi \ge 0.9$ で固相の、 $\phi < 0.9$ ならば液相の熱拡散 率をとる)、L は凝固潜熱、Cpは定圧比熱である。図1 に示したようなデンドライト成長する場合には、結晶の 成長方向に明かな方位性があることを示す。しかし、式(1) では結晶成長の方向性が示されない等方性の式である から、このままでは図1のようなデンドライトの成長は 見られない。異方性は界面エネルギー $\sigma$ に関係したパラ メータ $\varepsilon$ に導入し、k回の対称性と異方性の強さ $\nu$ を与 えた次式として取り扱い、本研究ではk = 4、 $\nu = 0.03$ として計算する。

 $\eta = \epsilon \cdot (1 + \nu \cdot \cos k \theta)$  ···(8)  $\theta$ は固液界面と結晶の優先成長方向とのなす角度で次 式で与えられる。

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{\partial \phi / \partial y}{\partial \phi / \partial x} \right) \qquad \cdots (9)$$

また、何らかの「ノイズ」を加えなければ発達したデンド ライト2次アームは見られないので、ノイズは固液界面 近傍の液相領域(0.01 < ∮ < 0.5)の溶質濃度をランダム に±1%以内で変動させて与えることとする。この「異 方性」と「ノイズ」を与えること、また、どのような与え方 をするかがフェーズフィールド法の重要なポイントであ る。固液界面領域を0.1 < ∮ < 0.9の範囲とすると、パラ メータεとWは、

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{6\lambda \cdot \sigma}{2.2}} \qquad \cdots (10)$$

$$W = \frac{6.6\sigma}{\lambda} \qquad \qquad \cdots (11)$$

で与えられ、異方性を考慮した2次元フェーズフィール ド方程式は以下のようになる。

$$\begin{split} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= M \bigg[ \bigg[ \eta^2 \cdot \nabla^2 \phi + \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \cdot \bigg\{ \sin 2\theta \cdot \bigg[ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \bigg] \\ &+ 2\cos 2\theta \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \bigg\} - \frac{1}{2} \bigg\{ \bigg[ \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \bigg]^2 + \eta \cdot \bigg[ \frac{\partial^2 \eta}{\partial \theta^2} \bigg] \bigg\} \\ &\cdot \bigg\{ 2\sin 2\theta \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - \nabla^2 \phi - \cos 2\theta \cdot \bigg[ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \bigg] \bigg\} - \frac{\partial f}{\partial \phi} \bigg] \\ &\cdots (12) \\ \frac{1}{M} &= \frac{\varepsilon^2}{\sigma} \cdot \bigg\{ \frac{R \cdot T'}{V_m} \cdot \frac{1 - k^e}{m^e} \cdot \beta + \frac{\varepsilon}{D_L \cdot \sqrt{2W}} \cdot \zeta(c_s^e, c_L^e) \bigg\} \\ &\cdots (13) \\ \zeta(c_s^e, c_L^e) &= \frac{R \cdot T'}{V_m} \cdot \frac{d^2 f^S(c_s^e)}{dc_s^2} \cdot \frac{d^2 f^L(c_L^e)}{dc_L^2} \cdot (c_L^e - c_s^e)^2 \cdot \bigg] \\ &\int_0^1 \frac{h(\phi) \cdot \{1 - h(\phi)\}}{\{1 - h(\phi)\} \cdot \frac{d^2 f^S(c_s^e)}{dc_s^2} + h(\phi) \cdot \frac{d^2 f^L(c_L^e)}{dc_L^2}} \bigg\} \\ & \cdot \frac{d\phi}{\phi \cdot (1 - \phi)} \end{split}$$

# いすると と(c.e c.e)は次式の

# 合金の融液を希薄溶液近似すると、 $\zeta(c_s^{\circ}, c_L^{\circ})$ は次式のようになる。

$$\begin{aligned} \zeta(c_{s}^{e}, c_{L}^{e}) &= \frac{R \cdot T'}{V_{m}} \cdot (c_{L}^{e} - c_{s}^{e})^{2} \cdot \\ & \frac{h(\phi) \cdot \{1 - h(\phi)\}}{\phi \cdot (1 - \phi)} \cdot d\phi \\ \int_{0}^{1} \frac{\varphi \cdot (1 - \phi)}{\{1 - h(\phi)\} \cdot \{c_{L}^{e} - (c_{L}^{e})^{2}\} + h(\phi) \cdot \{c_{s}^{e} - (c_{s}^{e})^{2}\}} \end{aligned}$$

•••(14-b)



Fig. 3 Equilibrium phase diagram of Al - Cu alloy.

ここで、Rは気体定数、 $V_m$ は合金のモル体積、 $c_s^e$ 、 $c_t^e$ はそれぞれ固相、液相の平衡濃度、 $c_s$ 、 $c_t$ はそれぞれ固 相、液相の濃度、 $f'(c_s^e)$ 、 $f'(c_t^e)$ はそれぞれ固相、液相の 化学ポテンシャルである。 $k^e(=c_s^e/c_t^e)$ は平衡分配係数 で、 $m^e$ は平衡状態図における液相線のこう配であるが、 図3に示す状態図上のAB間の液相線のこう配で、 $m^e =$  $\{T_M - T(x, y, t)\}/c_t^e$ で与えられる。ここで $T_M$ は合金の 液相線温度である。また、T'は $T' = T_a - \dot{T} \cdot \Delta t$  ( $T_a$ ;初期 合金融液温度、 $\dot{T}$ ;融液の冷却速度、 $\Delta t$ ;数値計算にお けるタイムステップ)である。本研究では等温凝固、す なわち、融液が液相線温度以下に過冷、保持された状態 での結晶成長を考えることとし、すなわち、 $\dot{T} = 0$ であ り、 $T' = T_a$ である。また、 $\beta$ は結晶成長の動力学に関す る量であるが、本研究では $\beta = 0$ として無視することに する。

#### 3 計算結果と考察

#### 3.1 計算の流れと計算条件

合金の結晶成長の計算の大まかな流れを図4に示す。 また、Al-4.5mass% Cu合金の各種物性値と計算条件、 使用計算機の主要仕様を表1に示す。x – y 直交座標系 第1象限の原点に、表1に示した初期固相域を設定し、 固相の成長が y 軸対称であるとして第1象限のみを計算 し、y 軸対称性から第2象限データを作成して第1、2象 限での成長過程を描画(フリーソフトの「AV 似非」を使



Fig. 4 Flow chart diagram of calculation.

計算メッシュ寸法	$\Delta x = \Delta y = 0.01 \ \mu m$
計算メッシュ数	$x750 \times y750$
固液界面領域長さ	$2\lambda = 6 \cdot \Delta x$
初期固相域(種結晶)	x 0.28 μm × y 0.14 μm の二等辺三角形
タイムステップ	$\Delta t = 6.7$ nsec
液相の拡散係数	$D_L = 3.0 \times 10^{-9} \mathrm{m}^2 \mathrm{s}^{-1}$
固相の拡散係数	$D_s = 3.0 \times 10^{-13} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
界面エネルギ	$\sigma = 0.093 \text{ J} \text{ m}^{-2}$
合金の液相線温度 (≒Al融解温度)	<i>T<sub>M</sub></i> = 933 K
液相線のこう配	$m^{e} = -640.0 \text{ K mol}^{-1}$ ( at 900 K )
平衡分配係数	$k^{e} = 0.14$ (at 900 K)
合金のモル体積	$V_m = 10.547 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$
パーソナルコンピュータおよびプログラム言語	
機種	Dell Computer社 Dimension 8100
CPU (クロック周波数)	Intel社 Pentium 4 (1.4 GHz)
RAM & HD	256 MB & 60 GB
プログラム言語	Compaq社 Visual Fortran Professional Edition Ver. 6.5 (FORTRAN 90/95)

Table 1 Physical properties of Al-4.5mass% Cu alloy, conditions on numerical calculation, specifications of computer and programming language.

用)することとした。溶質濃度場 c とフェーズフィール ド場 ¢ により描かれた凝固界面形状の例を図5に示す が、結晶の形状はほぼ同一とみなせるので、今後は溶質 濃度場により結晶成長過程を描画することとする。な お、溶質濃度は0~1に正規化して描画している。



Fig. 5 Comparison of the view of crystal growth by the phase-field with that by the concentration-field.

#### 3.2 結晶成長におよぼす異方性とノイズの影響

前章で異方性とノイズを与えなければデンドライト 成長や発達した2次アームが見られないと述べたが、過 冷度 $\Delta T \cong 20$ Kについてその様子を図6に示す。ノイズ と異方性を与えない場合(図6左)、結晶は放射状に成



Fig. 6 Effects of the anisotropy and the noise added to the concentration at the solid-liquid interface on the crystal growth.

長してデンドライトの形状を描かず、先端が分裂してい る。異方性を導入することによりデンドライトー次アー ムの成長がみられるようになるが(図6中)、ノイズを 考慮することによってはじめて二次アームが成長する ようになる(図6右)。ノイズの物理的意味合いが不明 確ではあるが、二次アームがドッキングしないで相互に 干渉し合い、成長していく様子は実際の現象と符合して いる。

#### 3.3 結晶成長におよぼす融液過冷度の影響

図7にAl-Cu合金融液の過冷度と結晶成長の様子を示 す。過冷度が大きい場合、デンドライト二次アームの成 長は水平、垂直方向だけでなく、45°方向にも見られ、 二次アーム間の隙間はほとんどなく、三次アームの成長 も観察される。過冷度が40Kの場合は、一次アームと 二次アームの成長がほぼ同じタイミングで行われてい るため、三角形の種結晶がそのまま三角形を保つように 結晶が成長している。過冷度が小さくなってくると、水 平、垂直方向のデンドライト一次アームの成長が先に起



Fig. 7 Effects of the undercoolig of the melt of Al-Cu alloy on the crystal growth.



Fig. 8 Relation between the position of the tip of primary dendrite arm and time.

こり、遅れて二次アームが成長している。過冷度が小さ くなるにつれて、デンドライト二次アーム間の隙間が広 くなり、二次アームの成長方向も一次アームに対し垂直 になっている。なお、過冷度が10Kのときは、デンドラ イト二次アームの成長は見られなかった。

図8に結晶成長過程における垂直方向の先端位置の時 間変化を示す。各過冷度における界面位置は時間に比例 して変化している。すなわち、y軸方向に関する結晶成 長速度はほぼ一定である。ただし、過冷度が10Kの時 は、デンドライト主軸の長さが48µm付近からデンドラ イトの成長が見られなくなった。また、デンドライト主 軸が74µmまで成長するまでの所要時間は、過冷度が 20Kの時で、0.178msec、過冷度30Kの時で0.148msec、 過冷度が40Kの時では0.142msecであり、成長速度は過 冷度に単純には比例していない。

固液界面付近のフェーズフィールド $\phi$ の分布につい て、過冷度の影響を図9に示す。水平方向のデンドライ ト先端の位置がおよそ $L_x = 1.7 \mu m$ における場合を示す。 過冷度が20K~40Kの場合では、 $0.5 \le \phi \le 1$ では過冷度 の増大とともに $\phi$ は大きくなり、 $0 \le \phi \le 0.5$ では逆に過 冷度の増大とともに $\phi$ は小さくなっているが、過冷度が 10Kでは全般的に界面領域の $\phi$ 値が大きくなっている。 過冷度が10Kではある程度結晶が成長した後、成長が 停止し計算は収束しなかったが、このような $\phi$ の分布と 関係があると考えられる。

また、図10に固液界面付近の溶質濃度分布を示すが、 凝固によって固相(α Al相)から溶質(Cu)が排出され るので、固相の濃度が低下し、固液界面で溶質の濃度が 急激に増加している。濃化した溶質は固液界面から遠ざ



Fig. 9 Distribution of Phase-Field, φ, in the region of the solid-liquid interface.



Fig. 10 Distribution of the concentration of solute, *c*, in the region of the solid-liquid interface.

かるにしたがって、拡散によってその濃度を低下してい っている。過冷度の増大に伴い結晶成長速度が増大(過 冷度のおよそ2乗に比例)するので<sup>(13)</sup>、溶質が十分に拡 散しきらないために溶質濃度のピークは過冷度の増大 と共に増大しているものと考えられる。

### 3.4 結晶成長におよぼす平衡分配係数と液相線の こう配の影響

平衡分配係数を $k^e = 0.14$ から2倍の $k^e = 0.28$ に増大さ せた場合、また、図3におけるAB間の液相線のこう配 を $m^e = -640$ K・mol<sup>-1</sup>から $m^e = -960$ K・mol<sup>-1</sup>に増大 させた場合の結晶成長の様子について検討する。平衡分



Fig. 11 Modified equilibrium phase diagrams of Al - Cu alloy .

配係数や液相線のこう配を変えることは、図11(a)においてC点をC'点に、(b)においてB点をB'点にの移動させたことを意味する。図12に結晶成長過程の様子を示す。平衡分配係数を2倍にした場合、相当濃化した固相



Fig. 12 Effects of the equilibrium partition coefficient and the liquidus slope of the melt of Al-Cu alloy on the crystal growth.



Fig. 13 SEM View of microstructure of slowly solidified Al-4.5mass%Cu alloy.

が晶出することになり、図12からも明かである。水平 方向に伸びた一次デンドライトからの二次アームの成 長が著しく、三次アームの成長も見られ、密集した組織 になっている。また、液相線のこう配を1.5倍にした場 合は、液相線温度が低下するため、実質的な過冷度が 20Kから15K程度に減少するので、図7にも示したよう にデンドライト二次アームの成長は見られなかった。な お、液相線のこう配はパラメータ Mに含まれるので、 単に過冷度を小さくした場合と同じ結晶の成長の仕方 を示すとは限らない。また、図13に実際の凝固組織 (凝固区間の平均冷却速度は数K·s<sup>-1</sup>程度で、黒部がAl リッチ相である)を示すが、これまでに示したような結 晶とは異なっている。非常にゆっくりした冷却速度での 凝固であり、過冷度は極めて小さいこと、結晶核が無数 に出来る上に結晶の成長方向が不特定であることによ ってデンドライト状組織と言うよりは、セル状組織の様 相を呈している。

#### 4 おわりに

本研究では、合金の結晶成長過程のシミュレーション 手法として近年注目されているフェーズフィールド法 の概略を述べ、Al-4.5mass%Cu合金融液が液相線温度以 下に一様に過冷された等温凝固について、結晶成長過程 におよぼす過冷度、平衡分配係数および液相線のこう配 の影響について調べた。その結果、過冷度の増大に伴い 二次デンドライトアームの成長が一次アーム並に速く なり、樹枝間隙がほとんどない密な組織を呈した。平衡 分配係数が大きい場合は濃化した固相が晶出し、二次ア ームが発達して三次アームの成長も見られるようにな った。液相線のこう配をより急なものにすると、過冷度 が小さい場合と同様に二次アームの成長が見られなく なった。

本シミュレーションはフェーズフィールド方程式や 拡散方程式を陽解差分法で解いているため、デンドライ ト寸法と計算要素寸法の兼ね合いからタイムステップ を大きく取れない制約があり、プログラム量が少なくて パソコンでも十分計算可能なものでありながら、また、 必要以外の計算は極力省略するなどの工夫を加えつつ も、図6、図7などの最終図を得るまでに数時間あるい はそれ以上の時間を要している。計算機の性能が格段に 進歩しているとは言え、シミュレートできるのはまだこ の程度であるとも言える。本報告が凝固現象への興味付 けと現象の理解の助けになれば、また、数値解析に対す る興味付けになれば幸いである。 本研究を進めるにあたって東京大学大学院工学研究 科金属工学専攻 鈴木俊夫教授並びに同専攻大学院生 大出真知子氏(現在、(財)日本学術振興会特別研究員) に懇切丁寧なご教示、ご助言を賜った。ここに深甚の謝 意を表する。

#### 参考文献

- (1) 大中逸雄: コンピュータ伝熱・凝固解析入門、丸善 (1985).
- (2) 新山英輔: *鋳造伝熱工学、*アグネ技術センター (2001).
- (3) T. Suzuki, M. Ode, S. G. Kim and W. T. Kim : J. Crystal Growth, 237 - 239 (2002), pp. 125 - 131.
- (4) B. Nestler and A. A. Wheeler : Computer Physics Communications, 147 (2002), pp. 230 - 233.
- (5) W. J. Boettinger, J. A. Warren, C. Beckermann

and A. Karma : Annu. Rev. Mater. Res., **32** (2002), pp. 163 - 194.

- (6) M. Ode, S. G. Kim, W. T. Kim and T. Suzuki : Int.
  J. Cast Metals Research, 15 3 (2002), pp. 247 250.
- (7) C. W. Lan and Y. C. Chang : J. Crystal Growth, 250 - 3-4 (2003), pp. 525 - 537.
- (8) 小林 亮:日本結晶成長学会誌、18-2 (1991)、 pp. 209 - 216.
- (9) 鈴木俊夫:まてりあ、38-8 (1999)、pp. 620 623.
- (10) 鈴木俊夫、金 聖均、金 元泰:ふえらむ、5-4
   (2000)、pp. 237 241.
- (11)小山敏幸:まてりあ、42-5 (2003)、pp. 397 404.
- (12) 島岡三義:奈良工業高等専門学校研究紀要、39(2003)、掲載予定.
- (13) B. Chalmers: 金属の凝固(岡本 平、鈴木 章共 訳)、丸善(1985)、p. 100.